

FINEPLACER® core<sup>plus</sup>

## 全功能SMD返修作業系統

## The All-Round Solution

- » 高經濟性的將所以返修能力整合成一機使用
- » 堅固又牢靠的機台結構設計



效率超高的加熱系統

直覺性的用戶體驗

領先業界的008004返修技術

可追溯性的流程

JEDEC/IPC 的多方認證

半自動使流程更加簡易

即時監控每一道作業程序，大幅提升良率

手臂力道的精準控制

# 特色

# 最大的效益

Desoldering, site cleaning, solder paste printing, dispensing, reballing, soldering

將所有必要的返修流程濃縮為一整機  
讓您不用耗時又耗力的評估複雜的設備

氮氣式熱風作業

提供了均勻且可重複性的熱分佈作業

半自動拆迴焊作業

就算是不同的作業員，依然可以達到一致性的焊接結果，良率超高！

簡單的機械原理、使用介面

就算您是新手，依然可以快速上手使用，無需學習不同機台的特性，輕鬆完成作業

Component specific tooling with low thermal mass

高級應用程序和特定組件傳熱的增強範圍

Z軸精準的行程、力道控制

安全、快速地處理01005等微小元件

帶有固定光束分離器的視覺對位系統

超高重複性的置放作業精度

實時監控的攝影系統  
(200° 旋轉角度)

視覺監控的即時反饋，有效減少各流程製作的時間

數據庫的資料共享

大幅加快、簡單化Profile製作

冷熱氣體混合控制

在極小的工具上仍可有效地控制冷熱風的溫度  
以及出風量大小

同步控制所有相關流程

parameters: force, temperature, time, process environment, illumination, vision

最佳化的使每一次拆迴焊達到相同效果

## 多功能返修流程

- » 拆焊 / 零件半自動移除
- » 非接觸式除錫 / Solder removal
- » 植球 / 單顆錫球補焊
- » 刷錫 (元件, 電路板)
- » 沾錫 / 點錫
- » 對位 / 半自動零件置放
- » 復焊

## 多樣化應用領域

### Soldering of:

- BGA, µBGA/CSP, QFN, DFN, PoP, QFP, PGA, SON Mini LED
  - Small passives down to 008004 / 01005
  - RF shields, RF frames
  - Connectors, sockets
  - Sub assemblies, daughter boards

### Pin in Paste (PiP)

### Through Hole Reflow (THR)

Underfilled or coated components (reworkable)  
Rework on flex

**tekserve** 欣岩企業有限公司

221新北市汐止區新台五路一段106號5樓

T E L : +886 (2) 26962203

<http://www.tekserve.com.tw>

E-Mail:info@tekserve.com.tw

# Modules & Options

- » Bottom Heating Module (hot gas)
- » Component Presentation
- » Direct Component Printing Modul (DCP)
- » Dispenser Module
- » ID Code Reader
- » PCB Support
- » Process Gas Switching
- » Process Start Sensor
- » Process Video Module
- » Reballing Module
- » Solder Removal Module
- » Split Field Optics
- » Target Finder
- » Tray Support
- » Touch Screen
- » Zoom-Optics



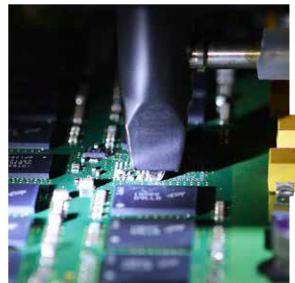
Process Video Module



Dispenser Module



Process Start Sensor



Solder Removal Module

